

一般社団法人溶接学会 マイクロ接合研究委員会  
歴代受賞者リスト

マイクロ接合功績賞

| 受賞年    |        | 受賞日       | 受賞者   | 所属            |
|--------|--------|-----------|-------|---------------|
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 片山茂   | 元 日本電気(株)     |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 仲田周次  | 大阪大学          |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 田中政直  | 元 石福金属工業(株)   |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 日置進   | 元 (株)日立製作所    |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 宮里孝典  | 元 精工舎         |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 青野進   | 元 日本アビオニクス(株) |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 牧野光男  | (株)東芝         |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 島田彌   | 三菱電機(株)       |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 関泰知   | (株)ニコン        |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 横井和雄  | 富士通(株)        |
| 1998年度 | 平成10年度 | H11年5月14日 | 窪田正   | 松下冷機(株)       |
| 1999年度 | 平成11年度 |           | 該当者なし |               |
| 2000年度 | 平成12年度 | H13年5月25日 | 野津誠   | 元 松下電子工業(株)   |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 池田順治  | 元 松下電器産業(株)   |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 竹本正   | 大阪大学          |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 河野英一  | 元 日本電気(株)     |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 佐藤英紀  | 元 日本アビオニクス(株) |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 清水俊夫  | セイコープレジジョン(株) |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 町田一道  | 元 三菱電機(株)     |
| 2002年度 | 平成14年度 |           | 該当者なし |               |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 渥美幸一郎 | (株)東芝         |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 河野顕臣  | (株)日立製作所      |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 齊藤亨   | 日鐵テクノリサーチ(株)  |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 田井英男  | 帝京大学 理工学部     |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 瀬尾健二  | 兵庫県立大学 大学院    |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 齋藤重正  | 富士電機機器制御(株)   |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 松村慶一  | 富士エクサス(株)     |
| 2005年度 | 平成17年度 | H18年5月26日 | 高橋康夫  | 大阪大学          |
| 2005年度 | 平成17年度 | H18年5月26日 | 岩見基弘  | 元 岡山大学        |
| 2006年度 | 平成18年度 |           | 該当者なし |               |
| 2007年度 | 平成19年度 |           | 該当者なし |               |
| 2008年度 | 平成20年度 |           | 該当者なし |               |
| 2009年度 | 平成21年度 |           | 該当者なし |               |
| 2010年度 | 平成22年度 | H23年5月27日 | 佐藤武彦  | 大阪大学          |
| 2010年度 | 平成22年度 | H23年5月27日 | 芹沢弘二  | (株)日立製作所      |
| 2010年度 | 平成22年度 | H23年5月27日 | 武井利泰  | 日本精工(株)       |

マイクロ接合功績賞

| 受賞年    |        | 受賞日       | 受賞者   | 所属           |
|--------|--------|-----------|-------|--------------|
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 藤本公三  | 大阪大学         |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 加柴良裕  | 三菱電機(株)      |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 荘司郁夫  | 群馬大学         |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 廣瀬明夫  | 大阪大学         |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 森郁夫   | (株)東芝        |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 岩田剛治  | 大阪大学         |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 佐藤了平  | 大阪大学         |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 出田吾朗  | 三菱電機(株)      |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 加藤力弥  | 千住金属工業(株)    |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 弘田実保  | (株)村田製作所     |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 大熊秀雄  | (有)HTO       |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 荘司孝志  | 元 昭和電工(株)    |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 気賀智也  | 元 ソニーEMCS(株) |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 鎌田信雄  | 化研テック(株)     |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 阪元智朗  | オムロン(株)      |
| 2012年度 | 平成24年度 |           | 該当者なし |              |
| 2013年度 | 平成25年度 |           | 該当者なし |              |
| 2014年度 | 平成26年度 |           | 該当者なし |              |
| 2015年度 | 平成27年度 |           | 該当者なし |              |
| 2016年度 | 平成28年度 |           | 該当者なし |              |
| 2017年度 | 平成29年度 |           | 該当者なし |              |
| 2018年度 | 平成30年度 |           | 該当者なし |              |
| 2019年度 | 令和元年度  |           | 該当者なし |              |
| 2020年度 | 令和2年度  |           | 該当者なし |              |
| 2021年度 | 令和3年度  |           | 該当者なし |              |
| 2022年度 | 令和4年度  | R5年5月12日  | 岩本知広  | 茨城大学         |
| 2022年度 | 令和4年度  | R5年5月12日  | 柴崎正訓  | (株)タムラ製作所    |
| 2023年度 | 令和5年度  |           | 該当者なし |              |

マイクロ接合研究賞

| 受賞年    |        | 受賞日       | 受賞者   | 所属                      | 受賞講演   |
|--------|--------|-----------|-------|-------------------------|--|
| 1995年度 | 平成7年度  | H8年7月24日  | 田中靖久  | 大豊工業(株)                 | 耐疲労性を向上させたはんだ合金の開発                               |
| 1995年度 | 平成7年度  | H8年7月24日  | 塚田敏彦  | (株)豊田中央研究所              | メニスコグラフ法における接触角測定技術の開発(2) - 接触角計測システム -          |
| 1995年度 | 平成7年度  | H8年7月24日  | 富岡泰造  | (株)東芝                   | レーザーシングルポイントILB技術                                |
| 1995年度 | 平成7年度  | H8年7月24日  | 村田敏一  | 松下電器産業(株)               | Pbフリーソルダの使用性能と問題点                                |
| 1995年度 | 平成7年度  | H8年7月24日  | 巽宏平   | 新日本製鐵(株)                | 狭ピッチボールボンディングにおけるAu-Al接合信頼性                      |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 荘司郁夫  | 日本アイ・ピー・エム(株)           | ワイヤボンダ用チップを用いた狭ピッチフリップチップアタッチ実装法                 |
| 1996年度 | 平成8年度  | H9年5月28日  | 森山正人  | (株)本田技術研究所              | 電装部品におけるハンダ接合の信頼性                                |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 苅谷義治  | 芝浦工業大学                  | Sn-3.5mass%Ag-X系合金ソルダの疲労特性に関する研究                 |
| 1997年度 | 平成9年度  | H10年4月17日 | 元山有子  | (株)富士通研究所               | 異方導電性接着剤を用いた素子接合の接合安定性                           |
| 1998年度 | 平成10年度 | H11年5月14日 | 田中直敬  | (株)日立製作所                | 吸湿による樹脂膨潤を考慮したICパッケージ接着界面のはく離発生評価                |
| 1998年度 | 平成10年度 | H11年5月14日 | 落合正行  | (株)富士通研究所               | ディンプルプレート法による微細バンプの形成                            |
| 1999年度 | 平成11年度 | H12年5月26日 | 下戸直典  | 日本電気(株)                 | 超多ピン半導体パッケージ用実装基板                                |
| 1999年度 | 平成11年度 | H12年5月26日 | 米田義之  | 富士通(株)                  | Super CSPの開発                                     |
| 1999年度 | 平成11年度 | H12年5月26日 | 後藤友彰  | 富士電機(株)                 | シリコンとセラミックスの陽極接合技術                               |
| 2000年度 | 平成12年度 | H13年5月25日 | 山中浩   | 松下電工(株)                 | MID技術による射出成形立体回路を応用した微小オプトデバイスの開発                |
| 2000年度 | 平成12年度 | H13年5月25日 | 成田敏男  | 北海道大学                   | Sn-Ag-Cuソルダの組織に対する組成と冷却速度の影響                     |
| 2000年度 | 平成12年度 | H13年5月25日 | 鳥越俊宏  | 日本電気(株)                 | レーザCVD技術と液晶表示装置への応用                              |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 山根常幸  | (株)東レリサーチセンター           | 接合界面の熱伝導現象解析                                     |
| 2001年度 | 平成13年度 | H14年5月23日 | 赤池信一  | タムラ化研(株)                | 鉛フリー対応水溶性耐熱プリフラックス                               |
| 2002年度 | 平成14年度 | H15年5月23日 | 八木能彦  | 松下電器産業(株)               | SBB方式フリップチップ実装における導電性接着剤接合技術                     |
| 2002年度 | 平成14年度 | H15年5月23日 | 秋山雪治  | 技術研究組合 超先端電子技術開発機構      | 20 $\mu$ mピッチ微細バンプ超音波接合技術                        |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 宮崎誠   | 長野沖電気(株)                | Sn-Ag-Cu鉛フリーはんだにおけるフローはんだ付け特性に及ぼす不純物の影響          |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 藤原伸一  | (株)日立製作所                | Auバンプを用いた接触接続の信頼性設計技術                            |
| 2003年度 | 平成15年度 | H16年5月14日 | 菅謙太郎  | (株)東芝                   | CdTe素子を用いた $\gamma$ 線検出器モジュールの開発                 |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 吉野睦   | (株)デンソー                 | ボンディングワイヤーのゲル中における共振のメカニズム解明と信頼性確保に関する研究         |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 今泉延弘  | (株)富士通研究所               | ハイエンドCMOSチップ向けアンダーフィル技術                          |
| 2004年度 | 平成16年度 | H17年5月27日 | 三代絹子  | 富士通(株)                  | BGAはんだ接合部のボイドが信頼性に及ぼす影響                          |
| 2005年度 | 平成17年度 | H18年5月26日 | 竹澤由高  | (株)日立製作所                | ナノ構造制御エポキシ絶縁樹脂                                   |
| 2005年度 | 平成17年度 | H18年5月26日 | 馬場陽一郎 | トヨタ自動車(株)               | HVインバーター品質確保の取組み                                 |
| 2005年度 | 平成17年度 | H18年5月26日 | 山部光治  | (株)東芝                   | Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだの熱疲労寿命予測式の構築と低・中融点Pbフリーはんだの寿命比較 |
| 2006年度 | 平成18年度 | H19年5月25日 | 粥川君治  | (株)デンソー                 | パワーデバイス裏面電極と鉛フリーはんだの界面構造と接合性                     |
| 2006年度 | 平成18年度 | H19年5月25日 | 守田俊章  | (株)日立製作所                | 半導体パッケージのはんだボール接合部に対する衝撃強度評価方法                   |
| 2007年度 | 平成19年度 | H20年5月30日 | 前田晃   | 三菱電機(株)                 | Sn-Ag-Cuはんだ中Au含有量が信頼性に与える影響                      |
| 2007年度 | 平成19年度 | H20年5月30日 | 青木雄一  | エスベック(株)                | はんだ接合部の熱疲労試験に及ぼす温度変化率の影響                         |
| 2007年度 | 平成19年度 | H20年5月30日 | 佐藤敦哉  | NECシステム実装研究所            | 異方性導電ゴムコネクタを用いた多段積層接続技術の開発                       |
| 2008年度 | 平成20年度 | H21年6月5日  | 坂本善次  | (株)デンソー                 | 両面放熱パワーモジュールの実装技術                                |
| 2008年度 | 平成20年度 | H21年6月5日  | 林真太郎  | パナソニック電工(株)             | MEMSチップ実装における応力緩和構造の研究                           |
| 2009年度 | 平成20年度 | H21年6月5日  | 鶴田加一  | 千住金属工業(株)               | Precoat by Powder Sheet(PPS)法による微小はんだブリコート形成技術   |
| 2009年度 | 平成21年度 | H22年6月11日 | 獅子原祐樹 | 大阪大学                    | 温度サイクル負荷による材料特性変化がはんだ接合部の疲労特性に及ぼす影響              |
| 2010年度 | 平成22年度 | H23年5月27日 | 作山誠樹  | (株)富士通研究所               | 低環境負荷プロセスの実現に向けた低温接合技術の開発                        |
| 2010年度 | 平成22年度 | H23年5月27日 | 江阪久雄  | 防衛大学校                   | Sn-Ag-Cu三元系鉛フリーはんだの凝固過程の解析                       |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 佐々木陽光 | (株)東芝                   | 銀ナノ粒子を用いた高信頼性ダイボンダ技術                             |
| 2011年度 | 平成23年度 | H24年5月15日 | 三橋和成  | (株)東レリサーチセンター           | 太陽電池モジュールの高分子部材の構造評価                             |
| 2012年度 | 平成24年度 | H25年5月24日 | 斎藤彰   | (株)村田製作所                | 熱衝撃Snウイスカの成長に及ぼす板状のNi-Sn金属間化合物の影響                |
| 2012年度 | 平成24年度 | H25年5月24日 | 澄川貴志  | 京都大学                    | 超微小試験片の作製と力学実験                                   |
| 2013年度 | 平成25年度 | H26年7月4日  | 島津武仁  | 東北大学                    | 原子拡散接合法によるウエハの室温接合技術の現状と課題                       |
| 2013年度 | 平成25年度 | H26年7月4日  | 東平知丈  | (株)日立製作所                | 高温対応熱電変換素子の接合技術                                  |
| 2014年度 | 平成26年度 | H27年6月5日  | 岩本知広  | 茨城大学                    | 超音波端子接合における界面現象                                  |
| 2015年度 | 平成27年度 | H28年5月20日 | 畠山友行  | 富山県立大学                  | 熱・電気連成解析を用いたパワーSi MOSFET内部の温度分布予測                |
| 2016年度 | 平成28年度 | H29年5月26日 | 八甫谷明彦 | (株)東芝ストレージ&デバイスソリューション社 | 半導体モジュール技術と分子接合技術                                |

マイクロ接合研究賞

| 受賞年    |        | 受賞日       | 受賞者   | 所属                 | 受賞講演                                       |
|--------|--------|-----------|-------|--------------------|--|
| 2017年度 | 平成29年度 | H30年7月27日 | 中崎義晃  | (株)ナノ・キューブ・ジャパン    | ナノ銅を用いたパワーデバイス向け新規導電材料                     |
| 2017年度 | 平成29年度 | H30年7月27日 | 谷澤秀和  | サンケン電気(株)          | SiC高温動作に向けたモジュール開発                         |
| 2018年度 | 平成30年度 | R1年5月31日  | 伊藤宏文  | (株)豊田中央研究所         | 半導体チップとCu基板のダイボンド構造における接合材が冷熱サイクル信頼性に及ぼす影響 |
| 2018年度 | 平成30年度 | R1年5月31日  | 松田朋己  | 大阪大学               | 酸化物還元反応を用いた窒化アルミニウムと金属の直接接合プロセス            |
| 2019年度 | 令和元年度  | R2年7月29日  | 藤原英道  | 古河電気工業(株)          | 銅ナノペーストの活性焼結メカニズムとその応用について                 |
| 2020年度 | 令和2年度  | R3年6月18日  | 井上雅博  | 群馬大学               | 導電性接着剤におけるフィラー/バインダ界面の化学的相互作用と電気伝導特性発達の関係  |
| 2021年度 | 令和3年度  | R4年7月29日  | 松坂壮太  | 千葉大学               | 固体イオン交換法によるガラス内金属析出物の形成とその応用               |
| 2022年度 | 令和4年度  | R5年5月12日  | 佐々木朋裕 | 新潟大学               | Al合金の超音波ろう付における接合部の形成過程                    |
| 2023年度 | 令和5年度  | R6年5月24日  | 小濱和之  | 地方独立行政法人京都市産業技術研究所 | 接合後に高融点化するSi基フィラーの材料設計とセラミックス高耐熱接合への応用     |
| 2023年度 | 令和5年度  | R6年5月24日  | 岸本貴臣  | 田中貴金属工業(株)         | パワーデバイスにおける接合材料の開発動向                       |